(11)特許出願公開番号

(12)公開特許公報(A)

(19) 日本国特許庁(JP)

特開2019-35656

(P2019-35656A)

(43) 公開日 平成31年3月7日(2019.3.7)

(51) Int.Cl.			FΙ			テーマ	・コード	(参考)
GO1B	15/04	(2006.01)	GO1B	15/04	К	2 F C	65	
GO 1 B	11/24	(2006.01)	G 0 1 B	11/24	К	2 F C	67	
GOGT	7/00	(2017.01)	GOGT	7/00	300D	9 5 B C	50	
G06T	19/00	(2011.01)	GOGT	19/00	А	5 L C	96	
				審査請求	未請求	請求項の数 7	OL	(全 13 頁)
(21) 出願番号		特願2017-156886	(P2017-156886)	(71) 出願人	5012416	45		

(22) 出願日	平成29年8月15日 (2017.8.15)		学校法人 工学	院大学	:		
			東京都新宿区西	新宿1	丁目2	4番2	号
		(74)代理人	110001519				
			特許業務法人太陽国際特許事務所 (72)発明者 馬場 則男				
		(72)発明者					
			東京都新宿区西	新 宿1	-24	-2	学校法
			人工学院大学内	I			
		Fターム (参	考) 2F065 AA52	AA53	CC16	DD03	FF04
			FF05	FF44	JJ19	JJ26	MM23
			PP24	QQ24	QQ31	RR07	
			2F067 AA53	CC19	EE04	GG06	GG07
			J J 05	KK04	LL16	NN05	RR35
			5B050 BA13	DA02	DA07	EA07	EA12
			EA18	EA27	FA02		
					最	終頁に	続く

(54) 【発明の名称】 3次元形状測定装置、3次元形状測定方法、及び3次元形状測定プログラム

(57)【要約】

【課題】複雑な3次元形状を精度良く測定することがで きる3次元形状測定装置、3次元形状測定方法、及び3 次元形状測定プログラムを提供する。

【解決手段】3次元形状測定装置18は、物体Mの表面 を複数の角度から撮影した複数の撮影画像を取得し、取 得した複数の撮影画像に基づいて、逆投影法により物体 Mの複数の断層像を算出する。

【選択図】図1



【特許請求の範囲】

【請求項1】

物体の表面を複数の撮影角度から撮影した複数の撮影画像を取得する取得部と、

前記複数の撮影画像に基づいて、逆投影法により前記物体の複数の断層像を算出する算出部と、

(2)

を備えた3次元形状測定装置。

【請求項2】

前記撮影画像の一部の画像をテンプレート画像として、前記複数の断層像の中から前記 テンプレート画像と一致する断層像を抽出する抽出部

を備えた請求項1記載の3次元形状測定装置。

【請求項3】

- 前記算出部は、前記複数の撮影角度の前記断層像の位置から算出した輪郭形状を合成し、合成した前記輪郭形状の欠損部分を補間する
- 請求項1又は請求項2記載の3次元形状測定装置。
- 【請求項4】
- 前記算出部は、前記複数の撮影画像の位置合わせを行ってから、逆投影法により前記物体の複数の断層像を算出する

請求項1~3の何れか1項に記載の3次元形状測定装置。

【請求項5】

前記複数の撮影画像は、走査型電子顕微鏡により撮影された画像である

- 請求項1~4の何れか1項に記載の3次元形状測定装置。
- 【請求項6】

取得部及び算出部を備えた3次元形状測定装置における3次元形状測定方法であって、 前記取得部が、物体の表面を複数の撮影角度から撮影した複数の撮影画像を取得し、 前記算出部が、前記複数の撮影画像に基づいて、逆投影法により前記物体の複数の断層

像を算出する

3次元形状測定方法。

【請求項7】

コンピュータを、請求項1~5の何れか1項に記載の3次元形状測定装置の各部として 機能させるための3次元形状測定プログラム。

【発明の詳細な説明】

- 【技術分野】
- [0001]

本発明は、3次元形状測定装置、3次元形状測定方法、及び3次元形状測定プログラム に関する。

【背景技術】

[0002]

特許文献1には、物体に向けて放出可能な電磁パルスを放出するための手段と、前記物体で反射される前記電磁パルスの輝度レベルを検出することができる2D光センサと、通信手段と、前記2D光センサが捕捉した2D画像から三次元の物体を再構成し、当該再構成に基づいて物体を識別可能にするコンピュータ処理手段とを含むオプトロニックシステムであって、前記2D光センサが、前記物体周囲の何通りかの観測角で捕捉される該物体の表面で反射される電磁放射の輝度レベルを表す物体の画像を記録し、前記通信手段が、反射モードで行われた逆ラドン変換を使用する前記物体の画像を処理すべく構成された断層撮影機能によって、三次元で物体を再構成できるよう、前記画像を前記コンピュータ処理手段に送信することを特徴とするオプトロニックシステムが開示されている。

特許文献2には、複数のカメラで撮影された複数枚の被写体の画像を取得するステップと、前記被写体を見る位置である仮想視点を決定するステップと、前記取得した被写体の 画像をもとに、前記視点から被写体を見たときの画像である仮想視点画像を生成するステ 10

20

ップとを有する仮想視点画像生成方法において、前記仮想視点画像を生成するステップは、多層構造をもつ投影面を設定するステップ1と、前記投影面上の各投影点と対応する、前記各被写体の画像上の対応点を求めるステップ2と、複数の対応点の色情報または輝度情報に基づいて前記投影点の色情報または輝度情報を決定するステップ3と、空間上のある基準視点から見て重なり合う複数の投影点について、前記各投影点の位置に相当する距離に前記被写体が存在する可能性の度合いに応じた混合処理をして、前報または輝度情報を、前記被写体が存在する可能性の度合いに応じた混合処理をして、前記仮想視点画像における各画素の色情報または輝度情報を決定するステップ5と、前記仮想視点画像の画素に相当するすべての点について、前記ステップ1からステップ5までを繰り返し行うステップ6とを有することを特徴とする仮想視点画像生成方法が開示されている。

[0004]

特許文献3には、立体像の標準モデルデータからなるデータベースと、複数枚の多視点 画像の画像データを取得する画像データ取得手段と、3次元データ作成装置を、前記複数 枚の多視点画像から3次元形状データを生成する3次元形状データ生成手段として機能さ せる3次元形状データ生成プログラムと、前記画像データ取得手段により取得した複数枚 の画像データからそれぞれ人物領域を抽出し、抽出した人物領域から検出した顔の特徴部 位と前記データベースの標準モデルデータとの対応点を取得してから、前記3次元形状デ ータ生成プログラムにより3次元形状データを得る3次元データ作成制御手段と、前記3 次元形状データを補正して顔の表情変化モデルデータを得る表情変化補正手段と、を備え 、前記表情変化補正手段は、表情の種類と表情動作単位の組合せを対応付けた対応表デー タと、表情動作単位と顔の筋肉の収縮部位を対応付けた対応表データを含み、顔の表情を 表情単位動作の組合せで表現し、各表上単位動作を対応する部位の顔の筋肉の収縮に変換 することにより、喜怒哀楽を示している表情のデータに補正する、ことを特徴とする3 次元データ作成装置が開示されている。

[0005]

特許文献4には、立体形状である対象物を複数の撮影点から撮影して得られたテクスチャ画像を用いて、指定された任意の仮想視点から見える映像を生成する任意視点映像生成 装置であって、前記テクスチャ画像の各撮影点の視線方向と前記仮想視点の視線方向との 間でなされる角度が小さい順に各テクスチャ画像に優先順位を付与し、該優先順位に従っ て混合する複数のテクスチャ画像を選択するブレンドテクスチャ画像選択手段と、該プレ ンドテクスチャ画像選択手段により選択された前記複数のテクスチャ画像の各撮影点にお ける前記角度が小さい程混合率が高くなるように各テクスチャ画像の各プレンド率を決定 し、該各プレンド率に従って前記複数のテクスチャ画像を混合してプレンドテクスチャ画 像を生成するプレンドテクスチャ画像生成手段と、該プレンドテクスチャ画 なまんするプレンドテクスチャ画像生成手段と、該プレンドテクスチャーマッピングし、 前記仮想視点から見える前記対象物の2次元の内挿映像を生成する内挿映像生成手段と、 を有することを特徴とする任意視点映像生成装置が開示されている。 【先行技術文献】 【特許文献】 【9006】

【特許文献1】特許第5891560号公報 【特許文献2】特許第4052331号公報 【特許文献3】特許第5206366号公報 【特許文献4】特許第5011224号公報 【発明の概要】 【発明が解決しようとする課題】 【0007】

50

10

20

30

10

20

30

40

今や肉眼で又は光学顕微鏡で視認できる物体の立体形状は、比較的手軽に3次元プリン タで複製することができる。 [0008]しかしながら、例えば電子顕微鏡でしか視認できないマイクロ・ナノレベルの複雑な3 次元形状については、3次元プリンタで複製するのは困難である。 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$ 本発明は、複雑な3次元形状を精度良く測定することができる3次元形状測定装置、3 次元形状測定方法、及び3次元形状測定プログラムを提供することを目的とする。 【課題を解決するための手段】 上記課題を解決するため、請求項1記載の発明の3次元形状測定装置は、物体の表面を 複数の撮影角度から撮影した複数の撮影画像を取得する取得部と、前記複数の撮影画像に 基づいて、逆投影法により前記物体の複数の断層像を算出する算出部と、を備える。 [0011]請求項2記載の発明は、前記撮影画像の一部の画像をテンプレート画像として、前記複 数の断層像の中から前記テンプレート画像と一致する断層像を抽出する抽出部を備える。 [0012]請求項3記載の発明は、前記算出部は、前記複数の撮影角度の前記断層像の位置から算 出した輪郭形状を合成し、合成した前記輪郭形状の欠損部分を補間する。 [0013]請求項4記載の発明は、前記算出部は、前記複数の撮影画像の位置合わせを行ってから 、逆投影法により前記物体の複数の断層像を算出する。 [0014]請求項5記載の発明は、前記複数の撮影画像は、走査型電子顕微鏡により撮影された画 像である。 [0015] 請求項6記載の発明の3次元形状測定方法は、取得部及び算出部を備えた3次元形状測 定装置における3次元形状測定方法であって、前記取得部が、物体の表面を複数の撮影角 度から撮影した複数の撮影画像を取得し、前記算出部が、前記複数の撮影画像に基づいて 、逆投影法により前記物体の複数の断層像を算出する。 [0016] 請 求 項 7 記 載 の 発 明 の 3 次 元 形 状 測 定 プロ グ ラ ム は 、 コ ン ピ ュ ー タ を 、 請 求 項 1 ~ 5 の 何れか1項に記載の3次元形状測定装置の各部として機能させるための3次元形状測定プ ログラムである。 【発明の効果】 [0017]本発明によれば、複雑な3次元形状を精度良く測定することができる、という効果を有 する。 【図面の簡単な説明】 [0018]【図1】3次元形状測定システムの構成図である。 【図2】3次元形状測定処理のフローチャートである。 【図3】複数の撮影角度で物体を撮影した場合について説明するための図である。 【図4】物体の撮影画像の一例である。 【図5】撮影画像の一部の濃度分布の一例を示す図である。 【図6】逆投影処理について説明するための図である。 【 図 7 】 X Z 平面における逆投影像の一例を示す図である。 【図8】XY平面における逆投影像の一例を示す図である。 【図9】テンプレート画像について説明するための図である。 【図10】テンプレートマッチング処理について説明するための図である。

50

【図11】テンプレートマッチング処理について説明するための図である。 【図12】逆投影像について説明するための図である。 【図13】逆投影像について説明するための図である。 【図14】逆投影像について説明するための図である。 【図15】輪郭形状の合成及び補間について説明するための図である。 【図16】3次元形状の他の例を示す図である。 【発明を実施するための形態】 [0019]以下、本発明の実施形態について説明する。 10 図1には、本実施の形態に係る3次元形状測定システム10の構成を示した。図1に示 すように、 3 次元形状測定システム 1 0 は、走査型電子顕微鏡 1 2 、テーブル 1 4 、駆動 部 1 6 、 及び 3 次 元 形 状 測 定 装 置 1 8 を 備 え て い る 。 [0021]走 査 型 電 子 顕 微 鏡 (Scanning Electron Microscope、SEM) 1 2 は 、 電 子 顕 微 鏡 の 一 種 であり、電子線を絞った電子ビームをテーブル14上の物体Mに照射する。そして、物体 Xから放出される二次電子等を検出することにより物体 Mを撮影する。走査型電子顕微鏡 12は、通常のカメラでは撮影が困難である微少な表面構造を有する物体を鮮明に撮影す ることができる。 20 [0022]駆動部16は、図1に示すように、テーブル14をXZ平面内で矢印A方向に回転させ る。これにより、複数の撮影角度で物体Mを撮影することができる。 [0023]3次元形状測定装置18は、制御部20、操作部22、表示部24、及び記憶部26を 備える。 [0024]制御部20は、図1に示すように、機能的には、取得部30、算出部32、及び抽出部 34を備える。 [0025] 30 取得部30は、物体Mの表面を複数の撮影角度から撮影した複数の撮影画像を取得する [0026]算出部32は、複数の撮影画像に基づいて、逆投影法により物体の複数の断層像を算出 する。 【0027】 抽出部34は、撮影画像の一部の画像をテンプレート画像として、複数の断層像の中か らテンプレート画像と一致する断層像を抽出する。 [0028]制御部20は、ハードウェア構成としては、図示しないCPU、ROM、及びRAM等 40 を含んで構成される。CPUは、後述する3次元形状測定処理をCPUに実行させるため の処理プログラムが記憶された記憶部26から当該処理プログラムを読み出して実行する 。なお、制御プログラムは、CD-ROM、メモリーカード等の記録媒体により提供する ようにしてもよく、図示しないサーバからダウンロードするようにしてもよい。 [0029]操作部22は、各種操作を行うためのマウス、キーボード等を含んで構成される。 [0030]表示部24は、例えば液晶ディスプレイ等で構成される。

【0031】

記憶部26は、後述する3次元形状測定処理の処理プログラムや、測定した3次元形状の形状データ等を記憶する。

(5)

[0032]

以下、制御部20で実行される3次元形状測定処理について図2に示すフローチャート を参照して説明する。

【 0 0 3 3 】

ステップS100では、物体Mの表面を複数の撮影角度から撮影するように走査型電子 顕微鏡12及び駆動部16を制御する。例えば、図1に示すように、テーブル14をXZ 平面内において矢印A方向に回転させながら、走査型電子顕微鏡12により物体Mが撮影 されるように、走査型電子顕微鏡12及び駆動部16を制御する。これにより、複数の撮 影角度から物体Mを撮影した撮影画像が得られる。

【0034】

本実施形態では、例えば図3に示すような物体Mの3次元形状を測定する場合について 説明する。物体Mは、物体M1、M2を含む。物体M1は、球の一部を切断した面に突起 M1 - A、穴M1 - B、及び模様M1 - Cが形成された形状となっている。また、物体M 2は、物体M1の近傍に離間して設けられ、棒状の形状となっている。

【0035】

図2には、物体Mを複数の角度から撮影した撮影画像G1~G7の一例を示した。なお、撮影画像G1~G7は、XY平面における撮影画像である。図3の例では、Z軸に沿った方向から物体Mを撮影した場合の撮影角度を0度とする。そして、図3においてZ軸の右側をプラス側、Z軸の左側をマイナス側として、XZ平面内においてZ軸から例えば右側に30度傾けた角度から撮影した場合の撮影角度を+30度、左側に30度傾けた角度から撮影した場合の撮影角度を-30度とする。図3では、説明を簡単にするために、一例として撮影角度が0度、+30度、+60度、+90度、-30度、-60度、-90 度の場合について示した。

【0036】

なお、本実施形態では、 - 9 0 度から + 9 0 度までを撮影範囲として、予め定めた角度 ずつ撮影角度を変化させて撮影した複数の撮影画像に基づいて物体 M の 3 次元形状を測定 する場合について説明するが、撮影範囲は、 - 9 0 度から + 9 0 度までに限られるもので はない。例えば、撮影範囲を - 9 0 度から + 9 0 度までの範囲よりも狭くしてもよいし、 広くしてもよい。例えば撮影範囲を 3 6 0 度としてもよい。また、予め定めた角度は、例 えば数度 ~ 数十度の範囲(例えば 1 ~ 1 0 度)の角度とすることができるが、これに限ら れるものではない。角度を小さくするほど精度良く 3 次元形状を測定することができるが、 、物体 M の形状の複雑さに応じて適宜設定すればよい。

ステップS102では、ステップS100で複数の角度から撮影した撮影画像の位置合わせを行う。具体的には、複数の撮影画像の各々について特徴点抽出処理を行い、抽出された特徴点に基づいて、複数の撮影画像における物体Mの位置合わせ処理を行う。なお、特徴点抽出処理及び位置合わせ処理は、種々公知の手法を用いることができるため、本実施形態での説明は省略する。

ステップ S 1 0 4 では、ステップ S 1 0 2 で撮影した複数の撮影画像に基づいて、逆投 ⁴⁰ 影法により物体の複数の断層像を算出する。

【 0 0 3 9 】

具体的には、撮影画像を撮影角度の軸(以下、撮影軸と称する)と直交させた状態で撮 影軸に沿って3次元空間上を移動させながら各画素の画素値を3次元空間上に配置してい く。

[0040]

図4に示すように、撮影角度が-30度の物体Mの撮影画像G3のうち例えば破線H1 上の画素値、すなわち濃度分布は、図5に示すような濃度分布Nとなる。なお、図4では 、濃度値が高い程濃度が薄いことを表している。図6は、-30度の撮影軸J3に沿って 3次元空間上に破線H1上の画素値が配置される様子を示している。図6に示すように、 10

破線 H 1 上の画素値は、撮影軸 J 3 に沿って 3 次元空間上に配置される。撮影画像 G 3 の 各画素値が撮影軸 J 3 に沿って 3 次元空間上に配置されることにより、撮影画像 G 3 が 3 次元空間上に逆投影される。

【0041】

このような逆投影処理を、撮影画像G1~G7のそれぞれについて行う。このとき、3次元空間上の同じ位置の画素に異なる撮影画像の画素が配置された場合は、各画素値を合算する。これにより、撮影角度毎に物体Mの複数の断層像が生成される。 【0042】

ここで、XY平面で物体Mをスライスした断層像は、物体Mの輪郭が比較的明瞭となる が、XZ平面で物体Mをスライスした断層像は、物体Mの輪郭が歪んでしまう場合がある 。図7にはXZ平面でスライスした断層像の一例を示した。また、図8には、XY平面で 物体Mをスライスした場合の断層像を示した。図7、8に示すように、XZ平面で物体M をスライスした断層像の方が、物体Mの輪郭が歪んでいるのが判る。これは、XZ平面に 並行な面内で撮影角度を変化させて物体Mを撮影した場合、XZ平面における物体Mの情 報量と比較して、XY平面における物体Mの情報量の方が多いためであると考えられる。 【0043】

そこで、ステップS106では、撮影画像の一部の画像をテンプレート画像として、複数の断層像の中からテンプレート画像と一致する断層像を抽出する抽出処理、すなわちテンプレートマッチング処理を実行する。

[0044]

具体的には、例えば撮影画像の一部の画像をテンプレート画像として、テンプレート画像を撮影軸に沿って移動させながら、テンプレート画像と断層像との相関値を算出する。 なお、断層像は、撮影軸と直交する面で物体Mをスライスした場合の断層像である。 【0045】

ここで、テンプレート画像がm×n(m、nは自然数)画素の画像である場合において、テンプレート画像の×座標i(1 i m)、y座標j(1 j n)の画素値をT(i、j)、断層像の座標(i、j)の画素値をD(i、j)とすると、テンプレート画像 と断層像との相関値Sは次式で表される。

$$S = \sum_{m}^{m} \sum_{i=1}^{n} T(i,j) \times D(i,j)$$

[0047]

 $i = 1 \ j = 1$

そして、算出した相関値Sのうち最も高い相関値Sを有する断層像をテンプレート画像 と一致する断層像とする。これにより、撮影軸上におけるテンプレート画像の位置が特定 される。そして、テンプレート画像と一致した断層像の画素値を、テンプレート画像の画 素値に置き換える。これにより、物体Mの輪郭が明瞭となる輪郭形状が算出される。 【0048】

例えば、図9に示すように、撮影角度が0度の撮影画像G4のテンプレート画像TMP についてテンプレートマッチング処理を行う場合、例えば図10、11に示すように、テ ンプレート画像TMPをZ軸方向に移動させながら、テンプレート画像TMPと断層像D Sとの相関値Sを算出する。そして、図10、11に示すように、Z軸方向における相関 値Sの相関分布のピーク部分、すなわち相関値Sが最大値となる断層像DSを、テンプレ ート画像TMPと一致する断層像とする。

[0049]

テンプレートマッチング処理は、テンプレート画像 T M P の位置を、 X Y 平面上において例えば予め定めた画素(例えば 1 画素)ずつずらしながら、撮影画像 G 4 の全領域について実行する。

10

【 0 0 5 0 】

このようなテンプレートマッチング処理を、異なる撮影角度で撮影した撮影画像G1~ G7の全てについて実行する。これにより、複数の撮影角度の断層像の位置から、物体M の輪郭が明瞭となる輪郭形状が算出される。

[0051]

図12には、物体Mの各部が3次元形状空間上に投影される様子を実線や破線の矢印で 示した。図12の投影部分K1は、図13の物体Mの輪郭R1に対応し、図12の投影部 分K2は、図13の物体Mの輪郭R2に対応し、図12の投影部分K3は、図13の物体 Mの輪郭R3に対応している。図13に示すように、輪郭R1のように、撮影画像の背景 等から輪郭が明瞭な場合は、各撮影画像の逆投影像のエッジの重なり部分がそのまま形状 となり得る。しかしながら、図13に示すように、物体M2の輪郭R3のように一部の輪 郭が欠損してしまう場合もあり得る。この場合は、後述する補間処理によって欠損箇所が 補間される。

【0052】

また、図14には、物体M1の穴M1-Bの穴の底のような微細な部分についても、撮 影角度を細かくして撮影することにより、逆投影によって特定できることを示した。 【0053】

なお、物体Mの形状が比較的単純な形状であり、テンプレートマッチング処理を行わな くても精度良く物体Mの3次元形状を測定できると考えられる場合には、ステップS10 6の処理を省略してもよい。

[0054]

ステップS108では、ステップS106の処理により得られた複数の撮影角度からの 輪郭形状を合成する。例えば図15には、撮影角度が-60度、0度、+60度の輪郭形 状DS1~DS3を合成し、輪郭形状DS4を生成した場合を示した。図15において、 例えば輪郭形状RNはステップS104の処理により復元され、その他の輪郭形状は、ス テップS106のテンプレートマッチング処理によって復元される。

【0055】

ステップS110では、ステップS108で合成された輪郭形状の欠損箇所を補間する 補間処理を行う。なお、補間処理については、種々公知の手法を用いることができるため 、説明は省略する。例えば、図15に示すように、輪郭形状DS4の欠損箇所Eを公知の 補間処理によって補間する。これにより、図15に示すように、欠損箇所が補間された輪 郭形状DS5が得られる。

[0056]

ステップ S 1 1 2 では、ステップ S 1 1 0 で得られた物体 M の輪郭形状を 3 次元形状と して表示部 2 4 に表示すると共に、復元した 3 次元形状の 3 次元形状データを記憶部 2 6 に記憶する。

【 0 0 5 7 】

このように、本実施形態では、物体Mの表面を複数の撮影角度で撮影し、撮影した複数の撮影画像に基づいて、逆投影法により物体Mの断層像を生成する。また、物体Mの輪郭が明瞭になるようにテンプレートマッチング処理を行う。これにより、複雑な3次元形状を精度良く測定することができる。本実施形態では、図3に示すような物体Mの3次元形状を測定する場合について説明したが、例えば図16に示すように、多重に絡み合った微絨毛のような3次元形状についても精度良く測定することができる。 【0058】

なお、本実施形態では、走査型電子顕微鏡(SEM)を用いた場合について説明したが、物体Mの表面を撮影できる顕微鏡であれば走査型電子顕微鏡に限られるものではない。 【0059】

また、本実施形態では、テーブル14を回転させて物体Mを複数の撮影角度で撮影する 場合について説明したが、電子線の照射方向を複数の角度に変えて撮影することが可能な 走査型電子顕微鏡12を用いて、物体Mを複数の撮影角度で撮影するようにしてもよい。 10

50

[0060]

また、物体がマイクロレベルやナノレベル等の微細なものでない場合、例えば肉眼で視認可能なものである場合は、通常の撮影カメラを用いてもよい。この場合、例えば撮影カメラを回転させることで複数の撮影角度で物体を撮影してもよいし、複数の撮影カメラを 円弧状に配置することで複数の撮影角度で物体を撮影してもよい。

- 【符号の説明】
- **[**0061**]**
- 1 0 3次元形状測定システム
- 1 2 走査型電子顕微鏡
- 14 テーブル
- 16 駆動部
- 18 3次元形状測定装置
- 2 0 制御部
- 22 操作部
- 2.4 表示部
- 26 記憶部
- 30 取得部
- 3 2 算出部
- 34 抽出部
- M 物体













【図5】







【図7】









【図11】







TMP

G4

【図12】













【図16】



フロントページの続き

Fターム(参考) 5L096 AA06 CA05 EA16 FA06 HA08 JA16